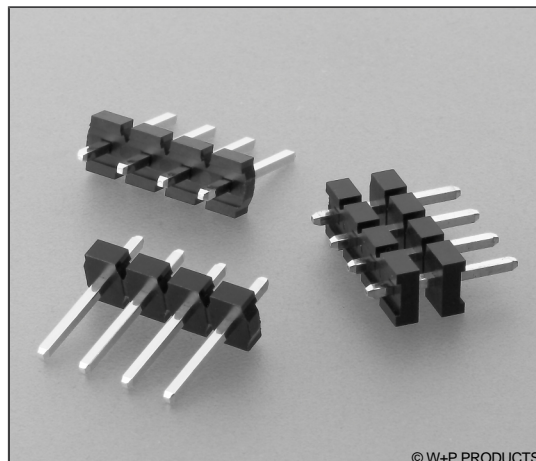


Stiftleisten RM 5,08mm, gerade – Power-Kontakte Pin Headers, 5.08mm Pitch, Straight – Power Contacts

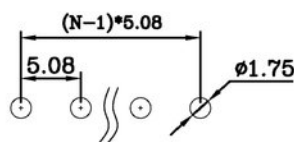
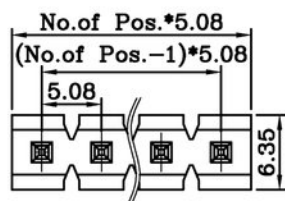
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Vierkantstift 1,14mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>1.14mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
<i>Test Voltage</i>	<i>500V_{AC}</i>
Nennstrom	7,9A
<i>Current Rating</i>	<i>7.9A</i>
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave or reflow soldering</i>

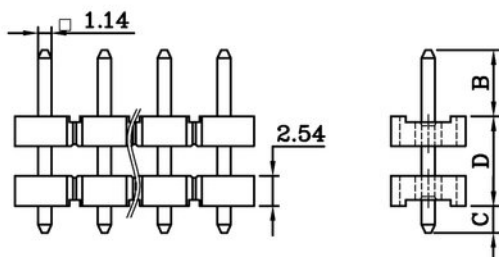


© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
395/396 3950 3960



RECOMMENDED PCB LAYOUT



Series	Dimensions*	Contacts*	Type	Plating
986	50	05	1	50
986 Dual Body	50 B=4,5 C=3,3 D=5,1mm 30 B=6,86 C=2,29 D=7,62mm 99 Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>	02-20		50 Verzinnt <i>Tin plated</i>

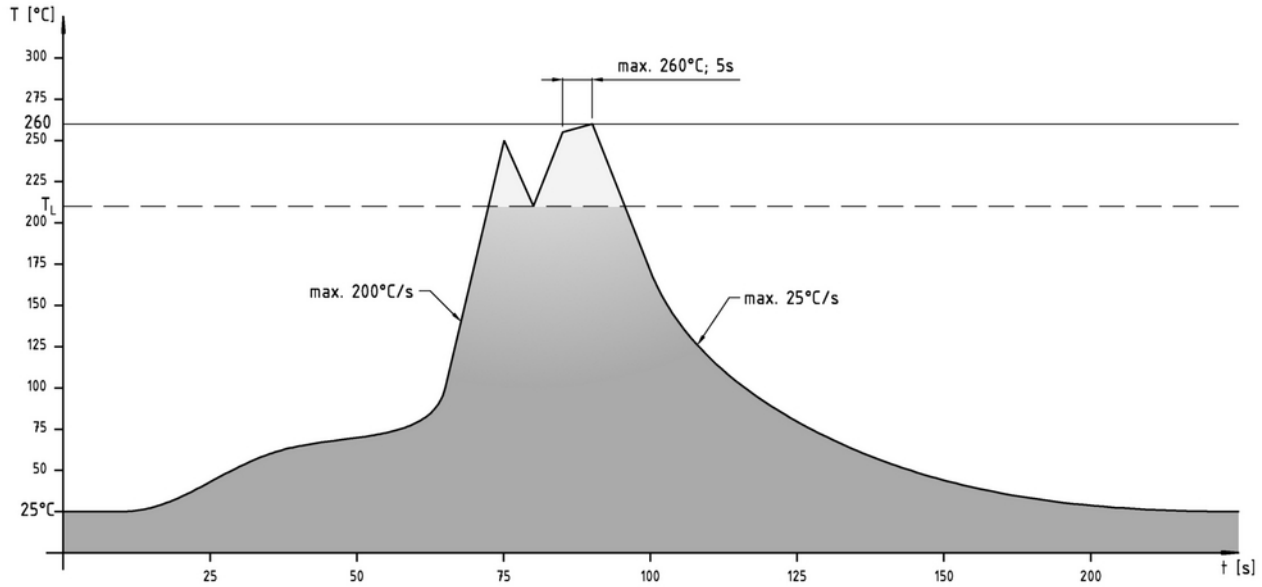
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

